

愛普科技股份有限公司

2025.08.05 法人說明會

林郁昕 財務長

大家午安，我是愛普科技財務長林郁昕，歡迎各位投資先進參與愛普科技法人說明會，在會議的初段，我們將進行本公司 2025 年第二季的財務狀況及業務報告，簡報過後會進入問答階段，線上參與的投資朋友可於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆。

免責聲明部分再請各位留意。

第 3 及第 4 頁是愛普科技的簡要資料，提供各位參考。

本次法說會會先由我來說明 2025 年第二季財務數字的重點，洪志勳總經理將報告營運狀況以及未來展望，之後進行 Q&A，今日的與會團隊除了洪志勳總經理及我之外，還有陳文良董事長、薛澤源業務中心副總以及劉宗寧產品中心副總也會在線上回覆提問。

首先由我這邊進行財務狀況報告。

首先說明 2025 年第二季的合併損益情形，愛普第二季在 IoT RAM™ 各個應用領域需求回升及 S-SiCap™ 產品線出貨大幅增加之下，單季合併營收金額為新台幣 13.3 億元，銷貨金額較第一季及去年同期分別增加 36% 及 41%，因愛普銷貨為美元計價，還原為美元銷貨來看，則美元營收季增 45%、年增 47%；第二季毛利金額為 5.6 億元，QoQ 及 YoY 分別增加 24% 及 16%。

第二季毛利率為 42%，QoQ 及 YoY 分別減少 4 個百分點及 9 個百分點，毛利率的減少除了受到第二季台幣升值的影響之外，各產品線銷售組合變化也影響了毛利率的下滑。本公司的銷貨及原料均是美元計價，但是因為晶圓成本是以入庫時的匯率來滾動計算，而使得毛利率有所波動，匯率變動對毛利率的影響將逐步隨著前期入庫晶圓的去化而漸趨平穩。毛利率 QoQ 的部份，本季的匯率升值影響了 2.8 個百分點，其餘 1.2 個百分點的減少，主要來自於 S-SiCap™ 營收增加的產品線組合不利影響。毛利率 YoY 減少 9 個百分點，其中匯率影響 2 個百分點，其餘則是受到較低毛利率的 S-SiCap™ 營收增加以及 IoTRAM™ 毛利率受市場競爭影響而下降的影響。稍後總經理會再做說明。

本季營業費用為 2.9 億元，較上季增加約 1,300 萬元，QoQ 增加 5%；較去年同期增加 3 仟 3 百萬元，YoY 增加 13%；營業費用的增加主要來自於研發費用的影響，研發費用季增 1 仟 3 百萬元，QoQ 增加 7%，年增 2 仟萬元，YoY 增加 10%。隨著研發人力的佈建及 VHM™、S-SiCap™ 各項專案的開展，預期研發費用的金額將會持續上升。營業費用率為 22%，營業費用金額雖然增加，但隨著新產品挹注營收的增加，使得營業費用率 QoQ 減少 6 個百分點，YoY 減少 5 個百分點。

營業利益為 2.7 億元，在營收大幅增加之下，雖然毛利率因為台幣升值及產品組合因素下滑，QoQ 及 YoY 金額仍然分別增加 55% 及 19%；本季營業利益率為 20%，QoQ 因毛利率下降及營業費用率下降而增加 2 個百分點，YoY 減少 4 個百分點，主要是毛利率下降的影響。

業外收支部分，第二季業外淨損失為 9.6 億元，主要來自於兌換損失 9.8 億元、利息收入 8,100 萬元、以及因投資標的外幣估值受台幣匯率升值影響所產生的金融資產評價損失 5,800 萬元的淨影響數。匯率波動產生的兌換影響數會在下一頁作詳細的說明。

第二季因兌換損失的影響，稅前淨損為 6.8 億元，所得稅利益 1.3 億元，稅後淨損金額為 5.5 億元，其中歸屬於本公司業主之稅後淨損為 5.46 億元，QoQ、YoY 分別減少 265% 及 247%，歸屬於本公司業主之稅後淨損率為 41%，單季每股虧損為 3.36 元。

匯率波動對於本公司的影響主要分成三個部份：第一是營收，因為本公司營收是採美元計價，新台幣每升值 1%，換算新台幣營收將下降 1%。

第二是毛利率，前面有提到，庫存金額受到匯率的影響是漸進式，匯率變動對毛利率的影響將逐步隨著前期入庫晶圓的去化而漸趨平穩；另外，每季銷售組合的變化也會影響毛利率變動百分比。平均新台幣每升值 1%，將使毛利率下降約 0.4 到 0.5 個百分點區間。

最後，也是最大的影響項目，則是在貨幣性金融淨部位因期末評價而產生的兌換損益。第二季度為 9.77 億元的帳面損失，來自於第二季底美元兌新台幣匯率 29.3，相較第一季底的 33.2 元，貶值 11.76% 的影響。本公司第二季底持有美元淨資產部位約 2.2 億美元，依第二季底匯率評價之後，會產生如圖所示不等的兌換損益。其中最主要的是最右邊的 BAR，集團現金及約當現金，也包含了 3 個月以上定存的部位，所產生的兌換損失，粉紅色的部份是 GDR 資金部位所產生的兌換損失約 7.1 億元，其餘則是一般營運與既有資金部位產生約 2.1 億元的兌換損失，合計 9.2 億元，加計應收付淨部位的兌換淨影響後損失 9.77 億元。

因本公司 GDR 募資資金除了研發投入之外，尚未大幅動撥，加上既有的外幣資金、應收付款等淨外幣的部位，持續會受到匯率波動的影響，尚未動用的部位承作定期存款，美元利率區間約在 4 到 4.5% 上下，每季可有 8 到 9 仟萬元左右的利息收入，平衡可能的匯率波動。排除 GDR 相關兌換損益及所得稅影響數的擬制設算資料一樣會在下一頁做說明。

本公司除了透過美元及新台幣的利差來提供一部分自然避險，也持續地考量地緣政治風險及整體營運佈局，將集團資金作區域分散配置。另外，也會再評估衡量可能的金融工具，抵銷金融資產所帶來的匯兌影響。

如果排除 GDR 未支用資金所產生的兌換損益，2025 年第二季業外淨損失為 2.5 億元，主要來自於既有外幣淨部位的兌換損失 2.7 億元、利息收入 8,100 萬元及金融資產評價損失 5,800 萬元的淨影響數。而將 GDR 相關匯率影響排除後，第二季淨利金額將轉正為 1,500 萬元，其中歸屬於本公司業主的稅後淨利為 1,900 萬元，QoQ 及 YoY 分別減少 93% 及 94%，歸屬於本公司業主的稅後淨利率為 1%。擬制調整後每股盈餘為 0.12 元。

GDR 資金的運用，本公司一直是比較謹慎的。這部分資金的目的是要投入研發和 3DIC 的生態。3DIC 生態的形態越來越清晰，我們預計在未來兩年內完成必要的投資，並將剩餘的 GDR 資金，申請改變資金用途，可能用於營運資金或其他。

為了更清楚地呈現營運狀況，這一頁排除了所有的匯率影響。這一頁的假設是美元對新臺幣匯率固定在 32 元，擬制設算可能的損益狀況。在這樣的假設下，營收 QoQ 45%、YoY 47%，毛利、營業淨利穩定增加，營業淨利的部份 QoQ、YoY 分別為 111%、43%，考量

匯率影響以外的利息收入、金融資產評價損益等等的業外收支後，歸屬於母公司稅後淨利部份 QoQ、YoY 則為 28%、3%。

整體來說，若排除因不可控的匯率波動而帶來的損益影響後，愛普營運持續穩定發展成長。

接下來是合併資產負債表的部分，季底總資產為 132 億元，較第一季底減少 5.3 億元。其中，現金及約當現金為 47 億元、按攤銷後成本衡量之金融資產為 48 億元，總計金額約 95 億元，合計占總資產約 72%。按攤銷後成本衡量之金融資產是本公司承作三個月以上定期存款。與第一季底現金及按攤銷後成本衡量之金融資產這兩個科目的合計數相較，淨減少數約 4.4 億元，除了受到匯率評價影響之外，主要來自於營業活動應收帳款的回收、定存利息所帶來的現金流入、合約負債預收的貨款、應付帳款支付貨款、所得稅支付及其他相對營業項目支出的現金流出互抵後的淨影響數。

第二季底應收帳款 5.1 億元，較第一季底減少 2,600 萬元，收款天期維持在 1 到 2 個月，整體應收帳款回收狀況良好。存貨金額為 9.5 億元，較第一季底減少 1.7 億元，下降 15%，目前庫存下降到 5.5 個月，本公司認為 7 個月左右為庫存的合理水位，本季度庫存降低是來自於客戶拉貨的影響，將持續依據接單狀況來動態管理。

本季度透過損益按公允價值衡量之金融資產約季減 6,900 萬元，主要是本公司海外投資部位，因為新台幣大幅升值導致公允價值下降的影響。

本公司在四月自公開市場增加對來頡科技的持股計 987 仟股，採用權益法之投資金額因此相應增加。

第二季底的總負債為 24 億元，負債比率為 18%，較第一季底減少 3,400 萬元，主要是合約負債增加 2.3 億元、應付帳款增加 4,700 萬元及應付所得稅減少 3.2 億元的淨影響數。YoY 負債比率增加了一個百分點，主要是應付帳款及合約負債的增加。公司把客戶的預付款列為合約負債。

股東權益總金額為 108 億元，由於本公司對 Onecent 並非 100% 持股，因此權益項目在本季相對產生了非控制權益 1.9 億元，減除該項非控制權益後，屬於本公司業主權益金額為 106 億元，因本季產生稅後淨損，因此較第一季底權益淨值 111 億元減少，每股淨值為 65.38 元。

以上是就財務資訊的相關說明，接下來的時間由洪志勳總經理說明營運狀況，謝謝！

洪志勳 總經理

好的，謝謝財務長。各位投資先進大家好，接下來由我為大家報告第二季的營運狀況。

本季的營運報告，跟前季一樣，會以 IoTRAM™、S-SiCap™ 以及 VHM™ 三個產品線的形式來分別為各位報告業績狀況。

愛普在 2025 年第二季的合併營收為 13.3 億元，較前季增加了 36%，YoY 增加 41%，營收增長主要來自於 IoTRAM™ 以及 S-SiCap™ 出貨增加。

本季 IoTRAM™ 營收 11 億元，占營收的 82%，QoQ 增加 28%，YoY 則是增加了 31%。VHM™ 產品線本季營收為 6 千 6 百萬，占比 5%，較前季及去年同期都增加了 1 仟萬左右，這主要是 NRE 的收入。S-SiCap™ 的部分，本季營收達 13%，金額為 1.7 億元，QoQ 增加

158%·YoY 則增加 210%·主要來自於 S-SiCap™ Interposer 多個專案於本季進入量產的挹注。針對各個產品線的營運狀況，在稍後會為各位進一步說明。

在營收快速增長的同時，本季毛利率為 42%，較前季下降了 4 個百分點，在下一頁有進一步地說明。

本季的毛利率較前季下降，主要是來自於兩個因素，其中台幣匯率升值產生的不利影響占了 2.8 個百分點，前面財務長有提到，隨著庫存逐漸消化，匯率對毛利率的影響將逐步減緩。另外 1.2 個百分點則是來自於產品線組合的不利變化，主要是本季 S-SiCap™ 出貨占比拉升。因為 S-SiCap™ 這個產品線剛剛開始起量，毛利率還比較低。我們預計 S-SiCap™ 這個產品線的毛利率在未來將有所提升。整體而言，近期因為匯率和產品組合的影響，總體的毛利率會在 Q2 的水平上下。

接下來說明盈利的狀況。在這一頁上，左邊淺綠色是營業利益，第二季的營業利益 2.7 億元，較前季成長 55%，來自於本季營收較前季增加以及季節性的營業費用占比減少，而 YoY 則是增加 19%。營業利益率 20%，較前季增加 2 個百分點，YoY 則是減少了約 4 個百分點。這主要是本季的毛利率較去年同期為低以及營收增加使得費用率占比降低的綜合影響。

從左下圖中我們可以看到，我們的營業利益雖然有季節性的波動影響，但是近期各季度的營業利益 YoY 呈現了一個正成長的趨勢。

右手邊圖是業外收支，這一頁呈現大幅的虧損，主要是因為台幣大幅升值造成的匯兌損失。這些匯兌損失是以台幣為功能性貨幣的帳面損失，不是實際的損失。

營收及毛利較前季有顯著地成長，但是，因為剛剛提到的匯兌損失，第二季的淨利為負

的 5.5 億，較前季減少了 8.96 億元，淨利率為-41.4%。

接下來我就三個產品線在今年第二季的營運狀況分別為各位先進說明。

首先我們來看 IoTRAM™產品線。

本季 IoTRAM™營收 11 億元，較前季增加 28%，年增 31%，各個應用領域的營收表現都有顯著地成長。

IoTRAM™的主要應用領域分為三塊，分別是 Connectivity、Wearable 以及 Video/Audio/ Others 這三個部分。針對這三個應用領域我將分別為各位說明。

首先是 Connectivity，主要是通訊模組、Wi-Fi 以及 Bluetooth 等等。Connectivity 應用在本季 IoTRAM™銷售中占比約 47%。這個應用市場需求今年開始有明顯地回溫，本季營收延續前季的成長趨勢，QoQ 增加 16%，YoY 則增加了 47%。

在穿戴裝置的部分，本季營收占 IoTRAM™29%，金額較上季增加了 43%，YoY 則成長 26%。

在 Video/Audio/ Others 的應用，營收部分較前季增加了 37%，YoY 增加 10%，這主要是 Display 的應用需求成長。這一塊業務在本季的 IoTRAM™營收中占比 24%。

接下來我針對 IoTRAM™各個應用領域，向各位做進一步地說明。

首先是 Wearable，穿戴裝置是一個蓬勃發展的市場，這個應用領域非常重視使用者的體驗。我們也觀察到這個市場主要是由主流品牌客戶來主導，這些客戶持續推出愈來愈多的各式裝置，功能也更為複雜多樣，再加上 AI，也就是 On-device AI 功能的導入，對記憶體容量以及頻寬的需求也持續成長，使得整體的銷量以及單機記憶體容量同時提升，為這個

應用領域帶來很大的一個成長空間。

另外，在 Connectivity 部分，這個應用市場的量體很大，價格競爭也非常的激烈，客戶成本壓力使得在單機記憶體容量需求有減少的趨勢。對於這個市場的經營，我們專注在與客戶的密切合作，推出更高性能、更好性價比的記憶體解決方案來增加客戶的產品競爭力，以繼續提升我們在這個應用領域的競爭優勢。

在 Display 這個應用，客戶看到了我們 IoTRAM™相較於傳統 DDR 不管是在效能或是整體成本的優勢，有愈來愈多的客戶在新一代的產品採用 IoTRAM™。我們對 IoTRAM™在 Display 這個應用的持續成長，深具信心。

另外，我們的 IoTRAM™在今年推出一個新世代的規格，也就是 ApSRAM™。ApSRAM™提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足了客戶對效能的渴求，並且在功耗上也降低了數倍，對穿戴裝置這類追求高效能以及長待機的應用，ApSRAM™是最佳的解決方案。目前已經獲得了多個客戶的採用，ApSRAM™預期在今年年底可以進入量產，在明年會對營收有所貢獻。

接下來是 S-SiCap™。

S-SiCap™產品線涵蓋了我們矽電容的各種形式的產品，其中包括了矽電容中介層，也就是 Interposers with S-SiCap™，也就是我們的 IPC，以及分離式的 S-SiCap™，我們叫做 IPD。IPC 與 IPD 雖然是出貨的形式不同，但是面向的是同一個應用市場。所以我們決定對 IPC 以及 IPD 的營收做一個合併的表達。

S-SiCap™產品線本季營收放量來到了 1.7 億元，較前季大幅成長了 2.6 倍，YoY 則是成

長 3 倍，這主要是本季 IPC 專案量產出貨的挹注。

IPC 從去年第三季開始量產，由於量產的初期成本還沒有穩定，毛利率還沒有達到預期，影響到本季整體的毛利率。目前我們看到客戶積極下單，隨著 IPC 量產專案數的累積，持續穩定放量生產，今年 S-SiCap™ 產品線的營收有望逐季成長。

另外就是在 IPD 的部分，嵌入 substrate 的應用目前還在製程驗證試產的階段，現在的出貨主要是驗證樣品的出貨，對目前的營收貢獻還不顯著。

接下來，我用這三張圖來說明我們 S-SiCap™ 在 2.5D 封裝的應用

首先是矽中介層，也就是以矽晶圓來做中介層。S-SiCap™ 嵌入矽中介層的應用，我們稱作 IPC。

這種 2.5D 的封裝技術在業界通常稱作 CoWoS-S，適用的面積是不大於四個光罩尺寸面積，也就是小於四個 Reticle Size 的晶片。由於 AI/HPC 耗能高、運算速度快，特別是 HBM3 以及 HBM3E 對 SI/PI 的要求也愈來愈嚴苛，矽中介層需要嵌入大量的電容。愛普的解決方案是目前市場少數比較成熟並且符合客戶規格需求的產品。我們預計今年 IPC 出貨將穩定成長，對今年的營收會有顯著的貢獻。下一代的 IPC 我們將電容值再提升一倍，我們預計在今年下半年導入量產，將持續擴大我們產品規格的領先優勢。

當 2.5D 封裝需要更大的面積的時候，molding-based interposer，如左中圖的部分，就是另外一個選項。SoC 與其他如記憶體等元件，以重佈線層就是 RDL 連接，再以封膠的方式結合。這種 2.5D 的封裝業界稱為 CoWoS-L。這個新的封裝型式，需要整合更多、更高容值的分離式電容，我們的 IPD 就是一個非常適配的解決方案，目前客戶在初期規格需求的

討論當中，量產還需要一點時間。

第三種是應用在嵌入封裝基板的應用，就是 embedded in substrate，如左圖下的部分。不管是 CoWoS-S 還是 CoWoS-L，未來都需要在基板中嵌入數十顆的 IPD。這個市場是非常大的。我們目前已經經營了一段時間，目前與客戶一起和多家的 Tier-1 基板廠合作製程開發以及驗證，製程驗證預計在今年年底、明年年初會完成，量產開始後起量的速度就要看客戶的專案需求。

在先進封裝隨著 AI/HPC 對算力的需求不斷提高，多晶片整合度愈來愈高，面積也愈來愈大，除了整合電容的矽中介層以外，我們看好未來不管是在 CoWoS-L 或是嵌入基板的 IPD 的需求，將會有更大的成長空間。

接下來我們來看 VHM™ 產品線。

本季營收台幣 6 千 6 百萬，較前季增加了 22%，主要是依專案進度認列的 NRE 收入。少量的 Wafer Sales 則是專案驗證的樣品出貨。

我們從 2018 年開始經營 VHM™，到目前大概可以分為三個階段。每個階段差不多都是三年。

第一個階段是 VHM™ 產品架構的早期概念設計驗證。這個階段我們與早期採用客戶合作驗證 VHM™ 的效能，並且和業界合作 3D Memory 供應鏈生態系的建立。第一個採用 VHM™ 架構的產品是乙太礦機，以一片 Logic 加一片 Memory，也就是我們所謂的 1+1。我們順利的在 2021 年第二季成功進入量產，目前累計出貨超過兩萬片。我們在礦機市場證明了採用 VHM™ 的價值，也就是我們可以利用比較成熟的製程，達到的效能大幅超過先進

製程的 GPU 數倍。此時主流客戶也開始注意到了我們 VHM™的價值，我們開始與客戶討論 VHM™在 AI 以及 HPC 的應用上的導入。

在第二個階段則是 VHM™的量產以及主流應用的導入。從 2022 年開始，我們的 VHM™已經成為乙太礦機的主流架構。除了持續經營礦機市場以外，我們經營的重點已經轉為 VHM™架構在主流應用的 POC 專案規格定義以及執行。這個階段，除了 1+1 的 VHM™架構以外，我們也開始與主流客戶進行多層堆疊的設計開發，也就是我們的 VHMStack™。這些專案在去年有完成階段性的驗證，客戶也開始跟我們進入量產產品的討論階段。

VHM™產品在今年進入了另外一個階段，重點專注於在主流應用的產品實現。我們與客戶合作的第一個針對 Edge AI 應用的多層堆疊架構的產品已經設計定案，下半年開始執行；另外也還有幾個產品與客戶在規格討論當中。產品開發到量產的時間會需要兩到三年，這些專案在進入量產之後，我們的 VHM™將進入量產的第四個階段，相信屆時 VHM™業績將會有爆發性的成長。

從市場的角度，我們看到越來越多的客戶開始自研 ASIC 作為 AI 推論的運算核心，也出現了越來越多 Edge AI 以及 On-device AI 的裝置，目前市場上的記憶體解決方案沒有辦法解決他們對效能、功耗以及成本的要求，客戶也注意到了我們 VHM™客製化解決方案的整體優勢。這就像當初礦機晶片由 GPU 轉換成 ASIC 一樣，我們認為在 AI 的推論以及 edge 端的應用這樣的趨勢已經開始了，在類似的經濟驅動力下，發展將會非常地快速。

以上是三個產品線在第二季的 Update。

接下來，我們來看到 Future Outlook，整體來看，延續上半年的成長趨勢，在 S-SiCap™的 IPC 業績大幅成長，以及 IoTRAM™市場需求擴大的帶動下，我們預期今年的業績會有顯著地成長。

另外，在 VHM™產品線，如剛才向各位所報告的，第一個 VHMStack™產品專案已經進入執行的階段，也有數個產品在設計導入的進行中，其中包括了單層也有多層的堆疊。有進展我們會在每季的法說會向各位報告。

另外，就是前一季我們在法說會也提到，現在的整體經濟環境有很多的不確定因素，包括美國高科技的管制以及關稅戰，特別是匯率的變動風險，都讓經營環境增添了許多的變數。我們將持續專注本業、提升產品的競爭力，並且與客戶密切合作，以因應滿足客戶在變化上面的一些需求。另外，我們會進一步擴大海外據點的經營，以分散地緣政治的經營風險。

以上是我的報告，謝謝。

Q&A

謝謝總經理。本次的簡報到這裡告一個段落，接下來進入問答階段，請各位投資朋友於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆，謝謝。

問題：請問目前對於 2025 年下半年營收的預期？2026 年？

回答：洪志勳 總經理

我們看下半年在 IoTRAM™以及 S-SiCap™的需求現在仍然很強，營收有機會能夠逐季的成長。另外，我們看這個趨勢有機會延續到 2026 年，但是隨著季節的波動，還是會有一些上下。

問題：假設匯率相對穩定之下，對於 25 年下半年毛利率的看法如何？

回答：洪志勳 總經理

毛利率的影響除了匯率以外，還有成本以及整體的產品銷售組合。那就像剛才報告中所提到的，IPC 由於剛導入還不穩定，那下半年的毛利率還是會有一些波動，那整體來說，我們有信心回到一個正常的區間。

問題：第二季毛利率降低不少，請問後續毛利率的趨勢看法？三個產品線的預期毛利率區間？

回答：洪志勳 總經理

好的，那在短期毛利率的部分，上一題有大概提到。

那我們以中長期來看的話，整體毛利率的區間我們會在 40% 到 50% 之間。那 S-SiCap™ 大概會落在這個區間的下半部，那 VHM™ 會在這個區間的上半部，大概是這樣的分布。

問題：請問 2025 年各個產品線的營收占比？

回答：薛澤源 業務中心副總

今年 SiCap 大概會占到整體營收的四分之一，其餘的部份中的九成左右是來自 IoTRAM™。

問題：請問 2026 年 IoT、AI BU、interposer、Si-Cap，各自的重點發展方向是？

回答：洪志勳 總經理

我大概說明一下我們現在這三個產品線的經營重點：

在 IoTRAM™ 的部分，除了新產品 ApSRAM™ 的量產以及應用面的擴大以外，隨著 AI 在 edge 端的應用導入，推出新的產品規格以滿足 AI 應用的記憶體需求，也是我們 IoTRAM™ 的另外一個重點。

那在 VHM™ 的部分，這個產品線這兩年有兩個重點，就是第一個產品專案的執行，也包括了單層以及多層堆疊的部分，那另外就是我們要持續經營我們的 3D 生態鏈。

對於 S-SiCap™的部分，我們專注在 HPC/AI 的先進封裝的需求，我們要密切跟客戶合作，不管是在中介層、CoWoS-S、CoWoS-L，以及嵌入基板應用的經營，以擴大整個應用面還有我們業績的增長。

問題：市場評估愛普在 Interposer 的出貨亮眼，超過原先預期，可以提供目前的月平均出貨量？對於下半年的出貨預期？月營收會有機會再持續成長嗎？

回答：洪志勳 總經理

我們 interposer 以現在來說，每個月出貨量是近千片左右。那預期在下半年持續會有新的專案進入量產，我們預期在下半年我們營收都會逐季繼續成長。

問題：近期台幣波動幅度極大，公司有很大的美金部位，請問因應方式？

回答：林郁昕 財務長

如同剛在報告中有提到，本公司主要是透過美元跟新台幣的利差來抵銷部分的匯兌損失，那也會持續地考量地緣政治風險、整體佈局，將集團資金作全球性的區域分散配置。同時我們也在評估採用不同的金融工具來抵銷金融資產匯兌評價造成的影響。

問題：對於 GDR 資金的運用有較明確的時程了嗎？

回答：陳文良 董事長

剛才財務長已經有提到我們是有一些進展。GDR 資金原來的目的是研發投入和 3DIC 供應鏈的投資。我們在未來兩年會完成我們認為必要的投資，並將剩餘的資金做一個目的變更，用於其他的用途。

問題：IoT in 2026，如果有成長，主要的成長動能是來自於既有應用或新的應用？可以說明一下方向及內容？

回答：劉宗寧 產品中心副總

在 2026 年 IoTRAM™的成長主要來自既有的產品應用，尤其是 Wearable 和 Display 的部分，因為消費者期待終端產品在畫面的品質以及功能應用上提升，同時也會帶動 IoT 記憶體容量及規格的升級。

問題：請說明一下 Interposer：目前主要的 business model？愛普主要的競爭優勢在哪？

回答：洪志勳 總經理

Interposer 目前還是以 Wafer Sales 為主，在 Licensing 以及 Royalty 的占比目前還不明顯。我們在市場上面有先行的優勢，體現在主要是技術的成熟度以及產品規格上面。我們持續在規格上，尤其是在單位面積的容值上面提高，能夠協助客戶產品的整體效能夠提升。我想簡單來講就是，我們的競爭優勢，就是讓客戶的產品有競爭力，謝謝。

問題：Interposer 在 2025 主要的成長動能來自於哪裡？是否有 2026 能見度？還是會因為 2025 的基期已高，2026 會趨緩？

回答：劉宗寧 產品中心副總

主要是台積電的產能無法滿足市場的需求，我們也逐漸看到非台積電的 2.5D 技術慢慢成熟起來，這些因素都驅動著對於 Interposer 的需求。目前看來客戶的需求在 2026 年依舊強勁。

問題：之前 SiCap 中分成 IPC 及 IPD，主要差別是？哪一塊會帶來比較大的營收貢獻？預計量產時點？

回答：劉宗寧 產品中心副總

IPC 是做為 CoWoS-S 的中介層，晶片的面積通常比 SoC 再加上多個 HBM 還來得大，那 IPD 則是以小晶片的形式存在，一次用好幾顆整合在 Package 的下面、或者在中介層裡面或者是基板內。IPC 在今年已經進入量產，會是接下來這幾年 S-SiCap™ 這個產品線內主要的營收貢獻，那 IPD 目前已經有多個項目和終端客戶及後端的供應鏈合作，我們認為明年有機會進入量產

問題：多層堆疊的 VHMStack™ 目前的進展？預計量產時點？供應鏈建置能夠趕得上客戶需求及時程嗎？

回答：洪志勳 總經理

那我先回答第二個部分，就是在供應鏈的部分。我們從 2018 年就投入了與業界合作建

立 WoW 的生態鏈。先進邏輯製程的堆疊驗證的部分，我們目前有幾個合作案在跟晶圓廠合作進行當中，預計在今年年底可以完成驗證，進行量產。

關於 VHMStack™的部分，我們有提到，就是我們現在已經有一個量產的專案正在執行當中，那量產的時間大概會落在 2028 年。供應鏈已經存在，使用這個供應鏈的整體產品，我們也正在進行設計驗證當中。

問題：越來越多公司在討論 WoW 這個技術/應用，請問愛普的優勢為何？

回答：陳文良 董事長

愛普的優勢是先行的優勢，主要體現在兩方面，第一方面是技術比較成熟，第二方面是客戶採用了愛普的介面。因為各家的介面不同，客戶採用了愛普的介面之後有一定的黏著性。

問題：WoW 目前主要量產的案子是礦機，請問 2026 年礦機的成長性為何？

回答：劉宗寧 产品中心副總

加密貨幣的市場相對來說比較不可預期，主要跟虛擬貨幣價格有很大的關係。2026 年的礦機業務成長性會來自客戶新型的礦機主晶片。客戶做新型號的礦機的動力是為了要提高性能。因為愛普的技術成熟、領先，而且已經有多次量產的經驗，我們可以和客戶有效率的合作來掌握每一次市場的機會。

問題：VHM™、IPC、IPD 都是跟 AI/HPC 相關，面對的是一樣的客戶群嗎？

回答：薛澤源 業務中心副總

是的，這兩個產品線的客戶群重疊性確實很高，那 S-SiCap™跟 VHM™所面對的主要主要客戶群是 AI 跟 HPC。

問題：公司曾經提過想要再找第二家代工廠，目前的進度為何？如果有第二家代工廠，主要的應用是？

回答：陳文良 董事長

長遠來說，我們一定要有三家 Tier-1 的 DRAM 廠支持，才有機會滿足主流客戶對產能

的需求。但是短期內，我們採用第二家代工廠的目的是給客戶提供最優化的產品規格，也是逐漸打造多家代工廠的生態環境。

問題：愛普的 WoW 在穿戴式產品的應用預期何時量產？高效能運算產品預計何時量產？

回答：劉宗寧 产品中心副總

針對穿戴應用的 WoW 產品已經在開發階段，同時和指標性的客戶討論新產品導入，有機會在明年底有產品開始量產。高效能運算應用的項目尚在 PoC 階段，項目的量產可能會在 2028 年。

問題：除了三個產品線之外，公司之前提到在 RFID 及 Power 部分有幾個投資案在合作進行，目前進展狀況如何？

回答：陳文良 董事長

RFID 主要是通過 Onecent 這家子公司在經營，產品目前已經在給客戶送樣，有機會明年開始量產。這一塊對我們來說是新的技術、新的市場，我們對量產時間的看法比較保守，但是我們對市場的潛力非常看好。

Power 這一塊主要是通過對來頡和 Power Lattice 的投資，主要的方向是 3DIC 的供電方案。目前還沒有可以揭露的進展。

問題：之前陳董事長提到終端裝置的趨勢是極致微型化，智慧眼鏡慢慢發展到最後也不用手機！請問未來智慧眼鏡的市場需求如何？這會是愛普的另一個藍海市場嗎？

回答：陳文良 董事長

穿戴市場我們已經經營了將近 10 年，最近確實看到一些比較大的變化。針對穿戴市場的 SOC 明顯地增加，性能也明顯提高。這個市場需要的是客製化的、超低功耗、超小面積、高頻寬的記憶體，這正是愛普的優勢所在。所以這個市場已經是我們成長的一個主要動能。

問題：七月中，研究機構有出報告指出 AI 運算需求從雲端延伸至終端裝置，WoW 堆疊技術是成為驅動 Edge AI 裝置革命的關鍵技術，WoW 更具經濟效益與彈性，適合應對低功耗、高頻寬、低成本的邊緣應用場景，而愛普在很早期就參加 WoW 技術開發並在加密礦機應用中量產，研究機構並樂觀預估愛普 WoW 後續營收貢獻，愛普有信心能夠達到這樣的成績嗎？

回答：陳文良 董事長

市場對 WoW 的市場潛力已經有不錯的共識。我們當然很有信心能夠實現 WoW 的市場潛力，但是我們對發展的時程一直比較保守。

問題：公司 VHM™今年的重點放在主流應用的產品實現，產品開發到量產預計兩到三年，預計這些量產專案量產之後，VHM™產品線將會有爆發性的成長，這樣算起來大約 2027 年到 2028 年有機會夢想起飛嗎？

回答：陳文良 董事長

VHM™產品，按照目前的 Design-In 進程，進入量產的時間確實應該落在 2027、2028 年。

問題：近期市場熱議，CoWoP 將取代 CoWoS 技術，成為未來 AI 領域的先進封裝趨勢，請問公司產品有無相關領域接觸？

回答：陳文良 董事長

CoWoP 指的是：不是 on Substrate，是 on Platform PCB。這個技術主要是取代了 Substrate，不是取代了 Interposer。但是先進封裝不管怎麼變，它都需要電容，所以我們在 S-SiCap™在先進封裝的應用這一塊，看法沒有變。

問題：美國自 8 月 7 號對全球徵收高低不一的關稅，部分機構下調下半年消費景氣。請問公司 IoTRAM™出貨狀況是否會受影響？

回答：薛澤源 業務中心副總

目前我們從過去這段時間的觀察，我們對美國市場沒有直接的出貨，那我們的客戶到目前為止，這個影響也不明顯。

問題：想詢問 IPD 開發進度？2025 年底開始量產是應用在 HPC 的產品嗎？以及有關矽電容技術？目前看起來國內先進製程廠商仍以本身深溝式技術為主。想詢問堆疊式技術是下一代具有更高電容值的主流解決方案嗎？

回答：洪志勳 總經理

我們現在 IPD 主要的應用，我們是 focus 在嵌入式基板的應用，那這一塊的主要都是 HPC 方面的需求。那另外就是 DTC 與我們 stack 這兩種 approach 的優劣，我想我們之前在幾次的法說會也跟各位先進有報告過，我們 stack 的方式可以達到單位面積更大的一個電容，而且我們在整個 form factor 上面，我們可以做到更輕薄短小。所以我們認為以我們這樣的一個架構是較 DTC 有優勢的。

問題：請問愛普當初至美國投資，是不是會減少關稅帶來的影響？

回答：陳文良 董事長

剛才薛副總有提到，美國關稅對我們的直接影響並不大。所以我們對美國投資主要不是為了關稅，而是我們要在美國更好地服務美國的客戶。

問題：請問公司有 1 到 2 年以及更長的三大產品目標營收占比？

回答：陳文良 董事長

這問題我簡單回答一下，因為長遠的比較難說。我們剛才已經回答過一個比例的問題，今年 IPC 明顯有成長，明年 IPC 還會繼續成長，明後年 VHM™也會上來。

所以我們總體來說，IoT 的比例會下降，其他產品線的比例會增加。

謝謝各位投資先進的提問，問答階段在此告一個段落，會後若有其他問題，各位可聯繫本公司 IR 團隊。

謝謝各位的參與，今天的會議到此結束，謝謝！

聲明

若逐字稿內容與法說會現場陳述內容有不一致之處，應以法說會現場陳述內容為準。

上述訊息所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性，任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況。

上述訊息中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。